

## **TUGAS AKHIR**

### **Analisa Pengendalian Kualitas Cacat Pada Unit PCB Line PSMT 3 Dengan Menggunakan Metode PDCA di PT. Indonesia Nippon Seiki**

*Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat  
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)*



**Nama** : **David Raymond**  
**Nim** : **41611110074**  
**Program Studi** : **Teknik Industri**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
JAKARTA  
2015**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : David Raymond  
N.I.M : 41611110074  
Jurusan : Teknik Industri  
Fakultas : Teknik  
Judul Skripsi : Analisa Pengendalian Kualitas Pada Unit  
PCB Line PSMT 3 Dengan Menggunakan  
Metode PDCA di PT. Indonesia Nippon  
Seiki

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib di Universitas MercuBuana. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis



(David Raymond)

## LEMBAR PENGESAHAN

### **Analisa Pengendalian Kualitas Cacat Pada Unit PCB Line PSMT 3 Dengan Menggunakan Metode PDCA Di PT. Indonesia Nippon Seiki**

Disusun Oleh :

Nama : David Raymond  
NIM : 41611110074  
Jurusan : Teknik Industri

Pembimbing,



( Ir. Sonny Koeswara, M. SIE )

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir / Ketua Program Studi



( Ir. Muhammad Kholil, MT )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kekuatan serta kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul ” **Analisa Pengendalian Kualitas Pada Unit PCB Line PSMT 3 Dengan Menggunakan Metode PDCA Di PT. Indonesia Nippon Seiki**”.

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis dapat belajar membandingkan serta menganalisa kesalahan / cacat produksi berdasarkan teori-teori yang penulis dapatkan selama belajar di Teknik Industri Universitas Mercu Buana, Hal ini juga sebagai salah satu syarat kelulusan guna melengkapi sebagian syarat dalam mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1), Jurusan Teknik Industri Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan baik moril maupun materiil kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah serta berkah terbesarnya dalam hidup.
2. Orang tua penulis, atas segala doa, dukungan, serta kasih sayang terbesarnya yang tak pernah habis.
3. Bapak M. Kholil ST, MT. selaku Kepala Program Studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta yang telah memberikan banyak pengarahan, saran, serta pembelajaran kepada penulis.
4. Bapak Ir.Sonny Koeswara, M.SIE selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu serta memberikan pengarahan, saran dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Panji, selaku Manager Assembly 3 yang telah memberikan banyak masukan dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan analisis Tugas Akhir di PT. INS.

6. Bapak Dani Wikartajaya, selaku Leader Line PSMT 3 yang banyak membantu, membimbing penulis dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi serta penulis bahas di PT. Indonesia Nippon Seiki.
7. Rekan – rekan yang telah memberi banyak semangat, serta dukungan di PT. Indonesia Nippon Seiki.
8. Teman – teman seperjuangan Teknik Industri Universitas Mercubuana Angkatan 2011-2015, terima kasih atas pengalaman terbaik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan guna kesempurnaan dan pembelajaran bersama ke depan yang lebih baik.

Akhirnya semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, 11 Juni 2015



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<i>i</i>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	<i>ii</i>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<i>iii</i>
<b>ABSTRAK</b>	<i>iv</i>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<i>vi</i>
<b>DAFTAR ISI</b>	<i>viii</i>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<i>x</i>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<i>xi</i>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<i>xii</i>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Pembatasan Masalah	2
1.4 Rumusan Masalah	3
1.5 Tujuan Penulisan	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Definisi dan Konsep Dasar Kualitas	6
2.2 Perkembangan Pengendalian Kualitas	9
2.3 Pengertian Pengendalian Kualitas	11
2.4 Peningkatan Kualitas	11
2.5 Faktor-Faktor Pengendalian Kualitas	12
2.6 Langkah-langkah Pengendalian Kualitas	13
2.7 Teknik atau Alat Bantu Pengendalian Kualitas	16
2.8 Sistem 8 Langkah Dalam Pengendalian Mutu	24

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Metode Penelitian .....	27
3.2 Pengumpulan Data .....	28
3.3 Analisis Hasil Pengolahan Data .....	29
3.4 Pembahasan .....	29

### **BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	31
4.1.1 Filosofi dan Kebijakan Perusahaan .....	32
4.1.2 Prinsip Kerja.....	32
4.2. Proses Produksi .....	33
4.2.1 Proses Produksi Speedometer .....	33
4.3. Ruang Lingkup Produksi .....	33
4.3.1 Line Produksi Speedometer .....	36
4.4 Produk Yang Dihasilkan .....	38
4.5 Pengumpulan Data .....	46
4.6 Pengolahan Data .....	54

### **BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN**

5.1 Analisa Diagram Sebab Akibat .....	57
5.2 Rencana Perbaikan .....	61

### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan .....	64
6.2 Saran .....	65

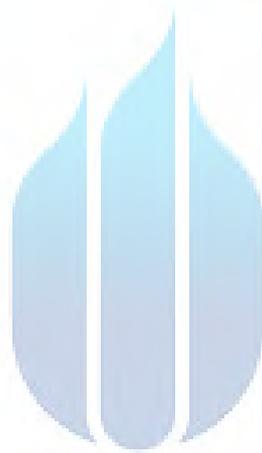
### **Daftar Pustaka**

## DAFTAR TABEL

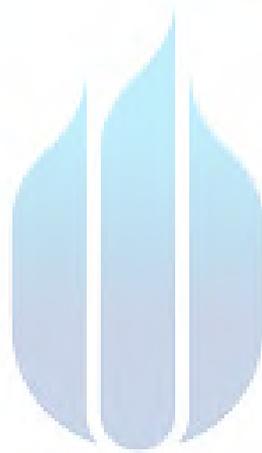
Tabel 2.1 Perbandingan Berbagai Peta Kendali .....	22
Tabel 2.2 Delapan Langkah Pemecahan Masalah dan Alat Bantu .....	26
Tabel 4.1 Jumlah Cacat produk PSMT 1PA bulan September 2014 .....	48
Tabel 4.2 Jumlah Cacat produk PSMT 1PA bulan Oktober 2014 .....	49
Tabel 4.3 Jumlah Cacat produk PSMT 1PA bulan Oktober 2014 .....	50
Tabel 4.4 Jumlah Cacat Produk PCB tipe 1PA selama 3 bulan .....	51
Tabel 4.5 Prosentase Cacat Produk PCB tipe 1PA selama 3 bulan .....	53
Tabel 4.6 Tabel Peta Kendali p .....	54
Tabel 5.1 Penyebab Dominan Tingginya Cacat Solderball part PCB tipe 1PA.....	60
Tabel 5.2 Rancangan Rencana Perbaikan .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus PDCA .....	14
Gambar 2.2 Contoh Check Sheet .....	17
Gambar 2.3 Contoh Diagram Pareto .....	19
Gambar 2.4 Contoh Diagram Fishbone .....	20
Gambar 3.1 Tahapan Proses Penelitian .....	30
Gambar 4.1 Peta Lokasi Perusahaan .....	32
Gambar 4.2 Jenis Produk Speedometer Roda Dua .....	39
Gambar 4.3 Jenis Produk Speedometer Roda Empat .....	39
Gambar 4.4 Jenis Produk Fuel Unit dan Speed Sensor .....	40
Gambar 4.5 Alur Proses Line PSMT .....	41
Gambar 5.1 Diagram Sebab Akibat Untuk Cacat Solderball .....	57



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA